

# **合肥晶合集成电路股份有限公司**

## **关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可在 2026 年 4 月 28 日（星期二）至 2026 年 5 月 7 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 [stock@nexchip.com.cn](mailto:stock@nexchip.com.cn) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 24 日发布公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果、财务状况和年度现金分红等情况，公司计划于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00 以网络文字互动形式参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

### **一、说明会类型**

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果、财务状况和年度现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午 15:00-17:00

(二) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

(三) 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

## 三、参加人员

董事长：蔡国智

董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理：朱才伟

独立董事：安广实

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

## 四、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0551-62637000 转 612688

邮箱：[stock@nexchip.com.cn](mailto:stock@nexchip.com.cn)

## 五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年4月24日